

⑮ 公開実用新案公報(U)

昭61-70262

⑯ Int. Cl.

G 06 K 19/00

識別記号

庁内整理番号

6711-5B

⑰ 公開 昭和61年(1986)5月14日

審査請求 未請求 (全2頁)

⑱ 考案の名称 カバー付メモリーカード

⑲ 実 願 昭59-152467

⑳ 出 願 昭59(1984)10月9日

㉑ 考 案 者 日 比 洋 長浜市三ツ矢町5番8号 三菱樹脂株式会社長浜工場内
 ㉒ 考 案 者 門 田 明 徳 長浜市三ツ矢町5番8号 三菱樹脂株式会社長浜工場内
 ㉓ 出 願 人 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号
 ㉔ 代 理 人 弁理士 近 藤 久 美

㉕ 実用新案登録請求の範囲

- (1) ICチップとICチップに接続された外部端子を有するIC基板をカード基体に形成した凹所に埋設したメモリーカードと、該メモリーカードの端部に嵌挿して上記外部端子を覆うカバーとからなるカバー付メモリーカードであつて、カバーによつて覆われるカード部分の厚みをカードの他の部分より薄くしてカバーを嵌挿したときカバーの裏面とカードの表面が各々面一となることを特徴とするカバー付メモリーカード。
- (2) 前記カバーが導電性材料である実用新案登録

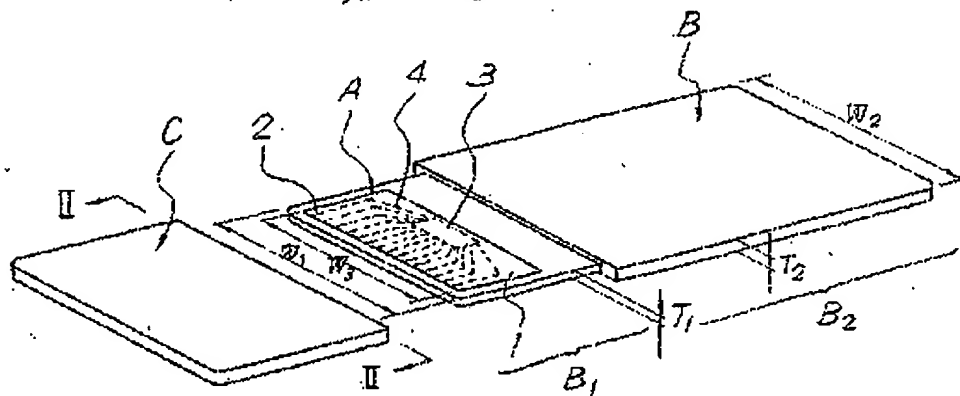
請求の範囲第1項に記載のカバー付メモリーカード。

図面の簡単な説明

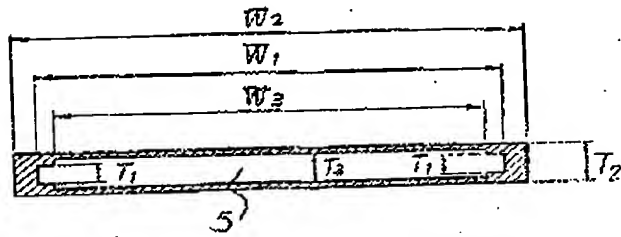
第1図は本考案のカバー付メモリーカードの一実施例を示す分解斜視図、第2図は第1図のII-II拡大断面図、第3図は該カバー付メモリーカードの端部拡大断面図、第4図は他の実施例を示す分解斜視図、第5図は第4図のV-V断面図である。

図中、AはIC基板、Bはカード基板、Cはカバー、1は基板、2は外部端子、3はICチップ、4はプリント配線、5は開口部である。

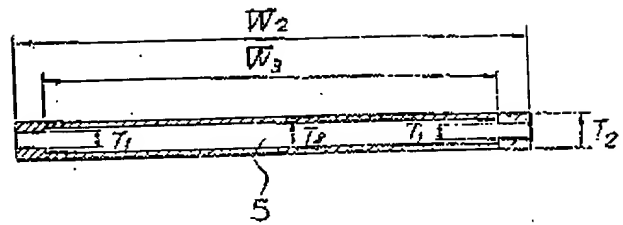
第 1 図



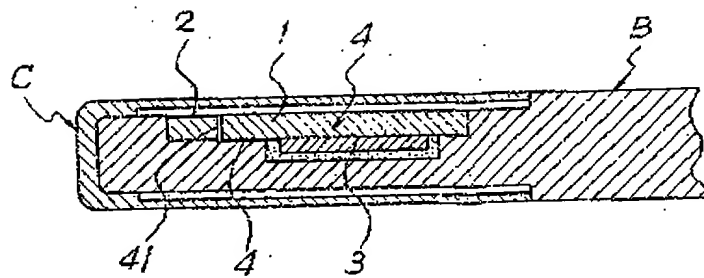
第 2 図



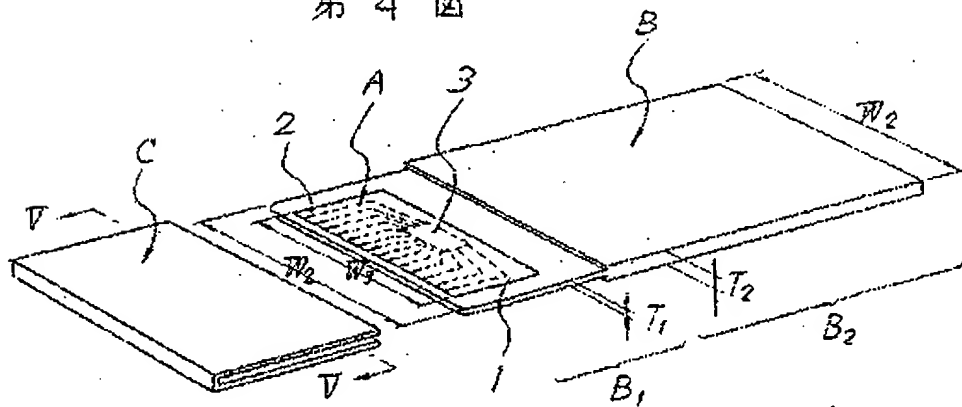
第 5 図



第 3 図



第 4 図



DESI AVAILABLE COPY

[CLAIM]

1. A cover part memory card comprising:

5 a memory card where an IC substrate having an IC chip and an external terminal adjacent to the IC chip is buried in a concave portion formed at a body of the memory card; and

a cover inserted into the end of the memory card to cover the external terminal,

10 wherein a cover part is thinner than the other part to make a cover surface flat when the cover is inserted into the memory card.

2. The cover part memory card as recited in claim 1, wherein the cover is made of a conductive material.

15

[BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS]

FIG. 1 is an exploded perspective view a cover part memory card according to an embodiment of the present invention;

20 FIG. 2 is an enlarged sectional view taken along a line II-II of FIG. 1;

FIG. 3 is an enlarge sectional view of the end of the cover part memory card illustrated in FIG. 1;

FIG. 4 is an exploded perspective view of a cover part memory card according to another embodiment of the present invention; and

25 FIG. 5 is a sectional view taken along a line V-V of FIG. 4.

A: IC substrate

B: card substrate

C: cover

1: substrate

2: external terminal

3: IC chip

4: print interconnect

5: opening

BEST AVAILABLE COPY